

小型な筐体に第10世代Core™を搭載し、 NVIDIA® RTX 30シリーズが搭載可能



画像処理・マシンビジョン向け タイニー型PC
IPC-C470SCQ-SC



- 第10世代インテル® Core™ プロセッサ搭載
- インテル® Q470Eチップセット装備
- NVIDIA® RTX 30シリーズ搭載可能
- USB3.2(Gen2)を計4基装備
- COMポートを2基装備
- 組み込みに適したコンパクトサイズ

✓ 長期安定供給を可能にするインテル® Q470Eチップセット

生產品質と効率向上を加速させ、長期安定供給を可能にするインテル® Q470Eチップセットと第10世代インテル® Core™プロセッサを搭載。マルチタスク処理の向上に適したハイパフォーマンス産業用コンピュータを実現。

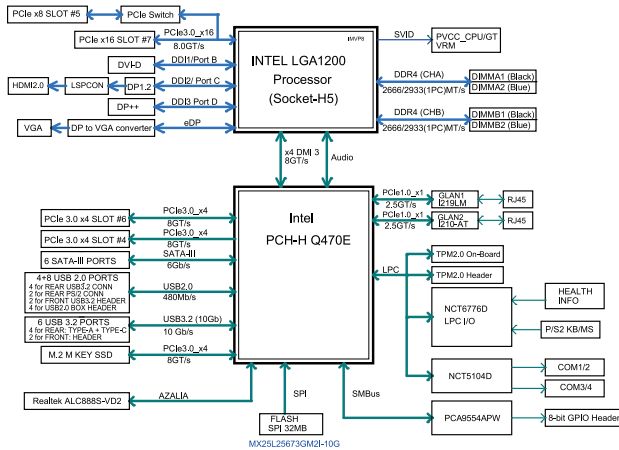
✓ コンパクト筐体ながらオプションでNVIDIA® GeForce RTX 30シリーズを搭載可能

Ampere世代のNVIDIA® GeForce RTX 30シリーズは、マシンビジョン、ディープラーニング、エッジコンピューティング分野で求められる計算負荷が高く並列処理による高速化の実現するGPU。前世代のRTX 20シリーズではGPUメモリが最大11GBのGDDR6だったのに対して、RTX30シリーズでは最大24GBのGDDR6Xと大幅に増強されています。

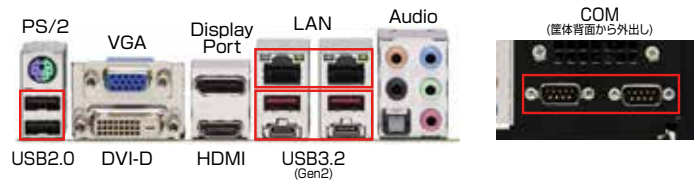
製品仕様

| | | |
|---------|---|---|
| モデル | IPC-C470SCQ-5C | |
| プロセッサ | 種類 | 第10世代インテル® Core™ プロセッサファミリー ※TDP最大65Wまでのインテル® Core™ i9 / Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® プロセッサをサポート |
| | 搭載数 | 1 |
| チップセット | インテル® Q470Eチップセット | |
| メモリー | 規格 | DDR4-2933 nECC |
| | 容量 | 標準16GB (8GB×2) ※最大128GB (32GB×4) |
| | スロット数 | 4 |
| ストレージ | 3.5インチベイ | 2 (空き:1) ※標準:リムーバブルにより2.5インチストレージ×2台搭載可能 |
| ODD | スリム型DVDスーパーマルチドライブ | |
| GPU | RTX 3060Ti ※オプション RTX 3070 ※オプション RTX3080 ※オプション | |
| グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス | |
| I/O | PS/2 | 1 (KB/Mouse) |
| | HDMI | 1 |
| | DisplayPort | 1 |
| | DVI-D | 1 |
| | VGA | 1 |
| | シリアル (COM) | 2 (筐体背面から外出し) |
| | USB | 前面 2 (USB2.0) / 背面 2 (USB3.2, Gen2, TypeA)、2 (USB3.2, Gen2, TypeC)、2 (USB2.0, TypeA) |
| | LAN | 2 (GbE) |
| | Audio | 6 (SPDIF-out, Surround-out, CEN/LFE-out, Mic-In, Line-in, Line-out) |
| 拡張スロット | Slot4 : PCI-Express x16 (Gen 3.0, x16/x8シグナル, CPU側) Slot3 : PCI-Express x4 (Gen 3.0, 4シグナル, PCH側) Slot2 : PCI-Express x8 (Gen 3.0, Non/x8シグナル, CPU側) Slot1 : PCI-Express x4 (Gen 3.0, 4シグナル, PCH側) | |
| 外形寸法 | スリムシャーシ W136mm × D376mm × H356mm (突起物等を除く) | |
| 重量 | 約9kg | |
| 電源 | 850W (連続最大容量 850W) 80 PLUS Gold | |
| 利用環境 | 入力電圧 | AC90V~240V |
| | 温度 | 10℃~35℃ |
| | 湿度 | 20%~80% RH (結露なきこと) |
| 保管環境 | 温度 | -10℃~55℃ |
| | 湿度 | 20%~80% RH (結露なきこと) |

ブロック図



I/Oポート



拡張スロット



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間:9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL : 03-5446-5535 mail : cto_sales@hpc.co.jp
WEBサイト : <https://embe.hpc.co.jp/>

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viviv、Intel Viviv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™ は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

2021年4月現在の内容です。